

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260710

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：鼎龙股份半年度业绩预告及经营近况交流
参与单位名称及人员姓名	2026年7月10日中午12:30~13:05：山西证券：傅盛盛，国泰基金：茅利伟，银华基金：华强强、唐泽辉，国泰海通：肖隽翀，华福证券：魏征宇，太平洋证券：王亮，上海理成：杨帆，国投证券：李玲，申万宏源：刘紫荃，中信建投：韩宇，交银施罗德：张三维，招商证券：张蓓，中银基金：陈婷婷，天风证券：孙浩宇，长江证券：李昌龙等，共260名投资者及证券人员
时间	2026年7月10日中午12:30~13:05
地点	进门财经线上会议
上市公司接待人员姓名	董秘杨平彩女士、董事长助理兼投关总监熊亚威先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司介绍：</p> <p>鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司，主营业务横跨半导体材料板块、锂电材料板块和打印复印关键材料板块等。现阶段，公司重点聚焦半导体创新材料业务，业务覆盖：半导体制造用CMP工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，是集成电路用CMP抛光垫国内供应龙头，占据OLED新型显示材料YPI、PSPI国内供应领先地位，深度布局半导体KrF/ArF晶圆光刻胶、半导体先进封装材料等业务，新近切入新能源锂电关键功能材料领域，推动公司高速可持续发展。</p> <p>问1：公司今年上半年度的预计业绩情况怎么样？</p> <p>答：鼎龙股份上半年预计实现营业收入约19.25亿元，同比增长约11%；预计实现归母净利润预计5.1~5.4亿元，同比增长63.96%~73.61%。若剔除出表的打印耗材终端业务利润，预计今年上半年公司归母净利润同比增幅超80%。其中：①CMP抛光液及清洗液：作为公司半导体材料重要的新增长极，鼎泽抛光液（含清洗液，不含体系内研磨粒子）业务上半年取得重大突破，合计营业收入同比增长63%，实现规模盈利约4,700万元。其中6月单月抛</p>

光液及清洗液的销售额突破 4,000 万元，创下月度销售额的历史新高。随着下半年销售规模持续增长，其竞争实力、毛利率水平及盈利能力将进一步提升。②CMP 抛光垫：营业收入同比增长 57%；其中 6 月单月出货首次突破 5 万片，创下月度出货量的历史新高。③高端晶圆光刻胶：本报告期合计约获得 1,000 加仑采购订单，产品批量交付规模持续提升中，国产替代进程显著提速。目前，公司已经累计布局 40 余款高端晶圆光刻胶，近 30 款产品向客户送样开展验证测试，在客户端的在测产品型号数量同比翻倍。同时，公司还布局了数款配套的 BARC、SOC 等光刻辅材。④半导体显示材料业务：尽管受下游显示面板厂产能稼动率不足因素的影响，公司显示材料业务收入同比略有下滑，呈现阶段性波动。但是，公司半导体显示材料产品的市场占有率及新产品覆盖度持续提升，业务整体竞争力显著增强。

问 2：请问董秘，今年下半年的展望如何？

答：公司预计 2026 年下半年相关业务将迎来新的增长，核心驱动因素主要体现在两大方面：一是公司相关材料产品市场占有率持续提升，市场竞争力稳步增强；二是在半导体显示材料领域，国内首条 8.6 代线已正式投产，公司核心显示材料产品 PSPI 与 INK 顺利在该产线实现首发批量配套供应，且公司是国内唯一一家有两款材料配套该 8.6 代线的企业，随着 8.6 代线产能逐步释放，相关显示材料业务将逐步放量，为下半年业务改善提供有力支撑。在业务影响因素方面，有三大核心要点对利润造成了一定影响：其一，耗材业务剥离对公司相关业务利润端存在一定影响，同比减少了一定利润，但是该影响随着剥离，只是阶段性影响；其二，公司加大了对高端晶圆光刻胶业务的研发投入对报表有一定影响，主要体现在受两大因素影响，一方面，公司光刻胶首条量产线已于今年 3 月正式投产，为业务后续发展奠定基础，折旧同比增加；另一方面，光刻胶国产化继续加速，研发投入同比增加；其三，显示材料受到下游客户稼动率不足影响，营业收入略有下滑。

展望下半年度，公司半导体材料业务产能利用率将持续提升，公司抛光液、清洗液产能主要集中在武汉、仙桃两地，今年 6 月上述产品出货量均创下历史新高，产能利用率提升空间较大，基于当前下游扩产以及材料国产化需求，公司下半年度业绩会持续提速。

综合来看，耗材剥离对公司的影响属于短期因素，后续将逐步消除。目前，公司抛光垫、抛光液等核心半导体耗材产品 6 月份出货量均创历史新高，已为下半年业务增长筑牢基础；显示材料业务有望伴随 8.6 代线产能释放实现环比改善；光刻胶业务受益于国产化加速及量产线投产，将持续推进商业化落地；抛光液、清洗液业务将依托现有产能，持续提升产能利用率，进一步释放业务增长潜力。整体而言，公司下半年各核心业务均具备良好的增长支撑，发展态势积极向好。

问 3：公司在玻璃基板配套材料领域的突破如何？

答：公司始终高度重视玻璃基板配套材料这一新兴赛道，已提前启动相关技术研发与产能规划工作。近期，公司取得重要市场突破，抛光垫产品成功获得板级封装领域核心客户的批量订单，将正式进入以玻璃基板为核心载

	<p>体的板级封装生产线投入使用。此次合作，是公司抛光垫产品在先进封装领域的又一里程碑，此前该产品已成功切入 2.5D、3D 封装产线，如今进一步拓展至板级封装领域，持续助力我国先进封装产业的高质量发展。此外，公司在潜江规划建设的第三条软抛光软垫生产线，设计年产能为 30 万片，该产线主要面向玻璃基板 CMP 软垫及 2 米以上大尺寸抛光垫两大增量市场，可精准匹配 HBM、光电共封装等行业新兴工艺的配套需求。</p> <p>玻璃基板作为先进封装领域下一代高密度互连的关键方案，对抛光材料的技术性能提出了更为严苛的要求。目前，公司自主研发的玻璃基板专用软抛光垫已完成多家头部封测企业及晶圆制造企业的送样工作，产品在工艺平坦度、划痕管控等关键技术指标上表现突出，各项验证工作正有序推进，整体进展符合预期。</p> <p>问 4：公司上半年在新领域的进展怎么样？</p> <p>答：公司在深耕集成电路用材料业务的同时，持续拓展大硅片抛光液、先进封装、碳化硅、玻璃基板等新兴领域，目前各领域均取得阶段性突破。在客户验证与订单获取方面，上述新兴领域均保持积极推进态势，客户验证工作有序落地，订单端也实现稳步突破，整体业务发展趋势向好，为公司后续业绩增长奠定了坚实基础。</p> <p>抛光垫业务方面，公司该业务实现营业收入同比 57% 的高速增长，经营成效显著。今年 6 月，公司抛光垫产品月度出货量首次突破 5 万片，创下月度出货历史新高，充分体现了下游市场对公司抛光垫产品的认可，也释放出业务持续向好的积极信号。</p> <p>为进一步匹配市场需求，公司已正式启动潜江三期抛光垫项目建设，该项目设计年产能 30 万片，重点聚焦玻璃基板专用 CMP 抛光垫、直径大于 2 米的大尺寸高端抛光垫等新品研发与量产，精准对接行业新兴应用需求。目前，抛光垫业务在现有较大业务基数的基础上，仍保持高速增长态势，且延续了产销两旺的高峰格局，市场竞争力持续提升。</p> <p>高端晶圆光刻胶业务作为市场关注的重点，公司在今年也取得了里程碑式的重要进展，相关技术研发与市场推广工作均按计划稳步推进，后续公司将持续聚焦该业务核心技术突破，加快商业化落地进程，力争为公司创造新的业绩增长点。</p> <p>问 5：公司自产研磨粒子的进展如何？</p> <p>答：仙桃新材料生产的研磨粒子产品对内配套销售，主要供应公司鼎泽新材料，作为其抛光液产品生产的核心上游原材料，实现集团内部产业链协同配套。随着鼎泽新材料 CMP 抛光液、清洗液销售规模持续增加，其竞争实力、毛利率水平及盈利能力将进一步提升，公司自产研磨粒子的供应链优势将得到增强。</p>
附件清单	无
日期	2026 年 7 月 10 日

